

第5回 北九州半導体 ネットワーク総会

2026年2月6日 金

特別講演

「メイド・イン・ジャパンの挑戦：
チップレット技術が拓く新次元への道」



Rapidus株式会社
専務執行役員
エンジニアリングセンター長
博士（工学）
折井 靖光 氏

時間 14:30-19:45

場所 リーガロイヤルホテル小倉

北九州市小倉北区浅野2-14-2

第1部 総会（北九州半導体ネットワーク会員限定）

時間 14:30-16:30（受付14:00～）

会場 3階 エンパイアルーム

費用 無料

第2部 特別講演会

時間 16:50-18:00（受付16:20～）

会場 3階 エンパイアルーム

費用 無料

第3部 交流会

時間 18:15-19:45（受付18:00～）

会場 4階 ロイヤルホール

費用 8,000円



一般申込



会員申込

申込締切
1/30

- ・総会は北九州半導体ネットワーク会員企業のみ参加可能です。（1社2名まで）
- ・特別講演会・交流会からはどなたでも参加可能で、1団体における申込制限もありません。

お問合せ

（公財）北九州産業学術推進機構 半導体産業支援センター内 北九州半導体ネットワーク事務局
住所 〒808-0135 北九州市若松区ひびきの2-1

HP <https://www.ksrp.or.jp/support/seicon.html>

TEL 093-695-3007 E-MAIL ksnet@ksrp.or.jp

主催 北九州市産業経済局未来産業推進課 / 公益財団法人北九州産業学術推進機構

【講師プロフィール】
1986年3月 大阪大学基礎工学部卒業。日本アイ・ビー・エム株式会社 野洲事業所入社、大型コンピューターの実装技術からノートブックコンピューター、ハードディスクなどのモバイル製品のフリップチップを中心とした実装の生産技術・開発に従事。
2009年6月 東京基礎研究所に異動し、3次元積層デバイスの研究をリード。
2012年8月 サイエンス&テクノロジー部長に就任し、脳型デバイス、光インターフェクト、半導体パッケージングの3つの研究分野を統括、新川崎事業所長に就任。
2016年7月 長瀬産業株式会社へ入社し、商社における技術の目利き役として活動を開始。
2017年4月 社長直下の組織として、NVC室(New Value Creation Office)を立ち上げ、2019年4月より執行役員に就任。
2022年12月 Rapidus 株式会社へ入社、専務執行役員・3Dアセンブリ本部長に就任。
2025年4月 専務執行役員・エンジニアリングセンター長に就任。

2012年9月 大阪大学工学部にて博士号取得。
2015年10月 IMAPS(International Microelectronics Assembly and Packaging Society) Fellow に就任。
2016年3月 IEEE EPS(Electronics Packaging Society) Region 10(Asia) Director に就任。